

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2026-015

杭州长川科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 634,402,614 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	长川科技	股票代码	300604
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邵靖阳		
办公地址	杭州市滨江区创智街 500 号		
传真	0571-88830180		
电话	0571-85096193		
电子信箱	investor@hzccotech.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司业务的基本情况

公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，是一家致力于提升我国集成电路专用测试设备技术水平、积极推动集成电路装备业升级的国家高新技术企业和软件企业。

公司自成立以来，始终专注于集成电路测试设备领域，掌握了集成电路测试设备的相关核心技术，目前

已拥有海内外专利超 1400 项，先后被认定为软件企业、高新技术企业、浙江省重点企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心、杭州市企业高新技术研究开发中心。公司产品获得了长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等多个一流集成电路企业的使用和认可，以自主研发的产品实现了测试机、分选机的部分进口替代。报告期内，公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念，持续加大技术研发投入，在将现有产品领域做专、做强，保持产品市场领先地位的基础上，重点开拓了覆盖 Soc、逻辑等多种高端应用场景的数字测试设备、三温探针台、三温分选机等产品，不断拓宽产品线，并积极开拓中高端市场。未来，公司将继续坚持“以客户为中心，以市场为导向”的宗旨，继续围绕探针台、数字测试机等相关设备进行重点研发，以突破国外半导体设备厂商的垄断，增强公司核心竞争力。


在巩固和发展公司现有业务的同时，为完善公司未来战略发展布局，进一步提升国际竞争力，公司于 2019 年完成了对 STI 的收购。通过收购 STI，公司在技术研发、客户和销售渠道等方面与 STI 形成了优势互补和良性协同。在技术研发方面，STI 的 2D/3D 高精度光学检测技术（AOI）居行业前列，通过公司与 STI 在研发方面的深度合作，STI 可为公司探针台等产品在光学领域技术难题的突破提供有力支持；在客户方面，STI 与德州仪器、安靠、三星、日月光、美光、力成等多家国际 IDM 和封测厂商建立了长期稳定的合作关系，为公司进入国际知名半导体企业的供应体系提供了有力支持；在销售渠道方面，STI 在马来西亚、韩国、菲律宾拥有 3 家子公司，并在中国大陆和泰国亦拥有专门的服务团队，能够随时为当地客户提供高效、快捷、优质的销售、产品维护及客户响应服务，可与公司销售布局产生协同，助力公司拓展海外业务。





公司于 2023 年完成了发行股份购买资产收购长奕科技（马来西亚 Exis）。EXIS 主要从事集成电路分选设备的研发、生产和销售，核心产品主要为转塔式分选机，EXIS 在转塔式分选机细分领域积累了丰富的经验。本次交易完成后，标的公司优质资产及业务进入上市公司，帮助上市公司丰富产品类型，实现重力式分选机、平移式分选机、转塔式分选机的产品全覆盖，通过上市公司与 EXIS 在销售渠道、研发技术等方面的协同效应，提升公司的盈利能力与可持续发展能力。

（二）主要产品

公司主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备，目前公司主要销售产品为测试机、分选机、自动化设备及 AOI 光学检测设备。公司生产的测试机包括大功率测试机、模拟测试机、数字测试机等；分选机包括重力式分选机、平移式分选机、测编一体机；自动化设备包括指纹模组、摄像头模组等领域的自动化生产设备；AOI 光学检测设备包括晶圆光学外观检测设备、电路封装光学外观检测设备等。

产品类别	产品名称	产品图例	产品介绍
测试系统 产品线	D9000 Soc 测试机系列		D9000 测试机是以量产测试数字类 IC 产品为目标的高性能集成电路测试机，可适应于芯片 CP 测试和 FT 测试，适用产品类型数字逻辑芯片、数模混合芯片、微处理器、系统级 SoC 及其射频类芯片，可适配各家 Handler 或 Prober。
	数模混合 测试机系列		代表产品：CTA8290D 高端多通道数模混合测试机，包含了 CTA8280F 的所有性能，同时适用于 PMIC、模组类 High pin count、以及数字功能要求较强的产品测试。

	老化测试机系列		代表产品：CM1028 老化测试机是以量产测试 SoC 芯片为目标的老化测试机，适用于车规级、AI 算法芯片等高可靠性应用场景要求的芯片的老化测试，最大支持测试 150W 功耗 SoC 芯片，可向下兼容。
	大功率测试机系列		代表产品：P3000 测试机是中高功率测试机，可测试 MOS、IGBT、SiC MOS 等功率器件，产品测试规格为 3000V400A，支持 DC、EAS、RgCg、DVDS、AC 等各类参数测试。。
自动分选系统	三温平移式分选机系列		代表产品：C6800T 是一款搭载三温 ATC 功能的 8 工位 ATE 测试 P & P Handler，自动 Tray 盘上下料，满足 -55° C~150°C 的三温测试要求。小功率版本适用于车载，手机等产品测试，适用于 GPU、服务器 CPU、AI 芯片等产品测试，最大支持 1150W。
	C6 系列		C6 系列适用于 ATE 测试 P & P Handler，具备多工位并测、高速度、高精度的测试能力，具备全方位的产品保护机制，适应行业标准 kit 具备快速更换的特性。该系列最大并测数有 4 工位、8 工位、16 工位等机型且配置的常高温可选。
	SLT 系列		代表产品：CS800T 是一款搭载 ATC 功能的 SLT 三温 Handler，支持 8site 并测，最大支持 1550w 控温、支持 Nest 多区控温功能、具备 Socket 吹气功能，可实现 Tj-40 高响应控温、支持 200kg 大压力 IC 测试，适用于 AI，CPU，网络芯片等测试环境。
	重力式分选机系列		代表产品：C9D 系列重力式测编一体分选机 C9D 系列是我司全新开发的测试编带光检一体式分选机，具有高速度、高精度、多工位并测等功能。整机采用模块化设计，具备多种收料方式，可由用户自由选择开启何种收料方式。

	转塔式分选机系列		EXIS 250/300 是一款高速转塔式分选机，最大支持 24 个吸嘴站位布局，整机采用独特的视觉系统，具备检测外观缺陷，Mark, OCR 等功能；设备标配 Bowl 进料，Tape & Reel 出料，并且可扩展支持 Tray, Tape, Tube 多种入料和 Tray, Tube, Bulk, Dual Tape 多种出料方式。
AOI 检测设备	HEXA		多功能光检编带一体机，具有真正的 3D 测量方式和 5 边侧面外观检测，最大检测能力为 100*100mm，具备 POP/eWLB/QFN/QFP/LGA/BGA/CSP 等产品的 TRAY TO TRAY 和 TRAY TO REEL 功能，多模组可灵活组合实现不同产品的检测要求。
	ifocus		晶圆外观检测设备，采用双镜头专利技术和明场暗场双重检测，可实现比竞争对手 4 倍的检测能力，实现更好的不良品检测能力&更低的漏检率，可支持产品的内部裂纹检测、红外检测、COG、CMOS 等的外观检测。
AOI 量测系统	NanoX-6000		NanoX-6000 全自动量测设备是针对半导体关键制程尺寸量测需求开发的一款全自动关键尺寸量测设备，用于产品的 CD 开口、线宽、线高、线间距、Pilar 直径、Overlay、EBR、大坝 (dam)、膜厚及粗糙度量测等。
	NanoX-8000		针对 PCB 基板关键尺寸量测需求，开发的一款 3D 光学轮廓仪 NanoX-8000，用于表面结构测量和表面形貌分析的一款检测设备，专业用于 PCB 基板表面粗糙度、三维轮廓、二维尺寸的检测。

(三) 公司主要业务模式

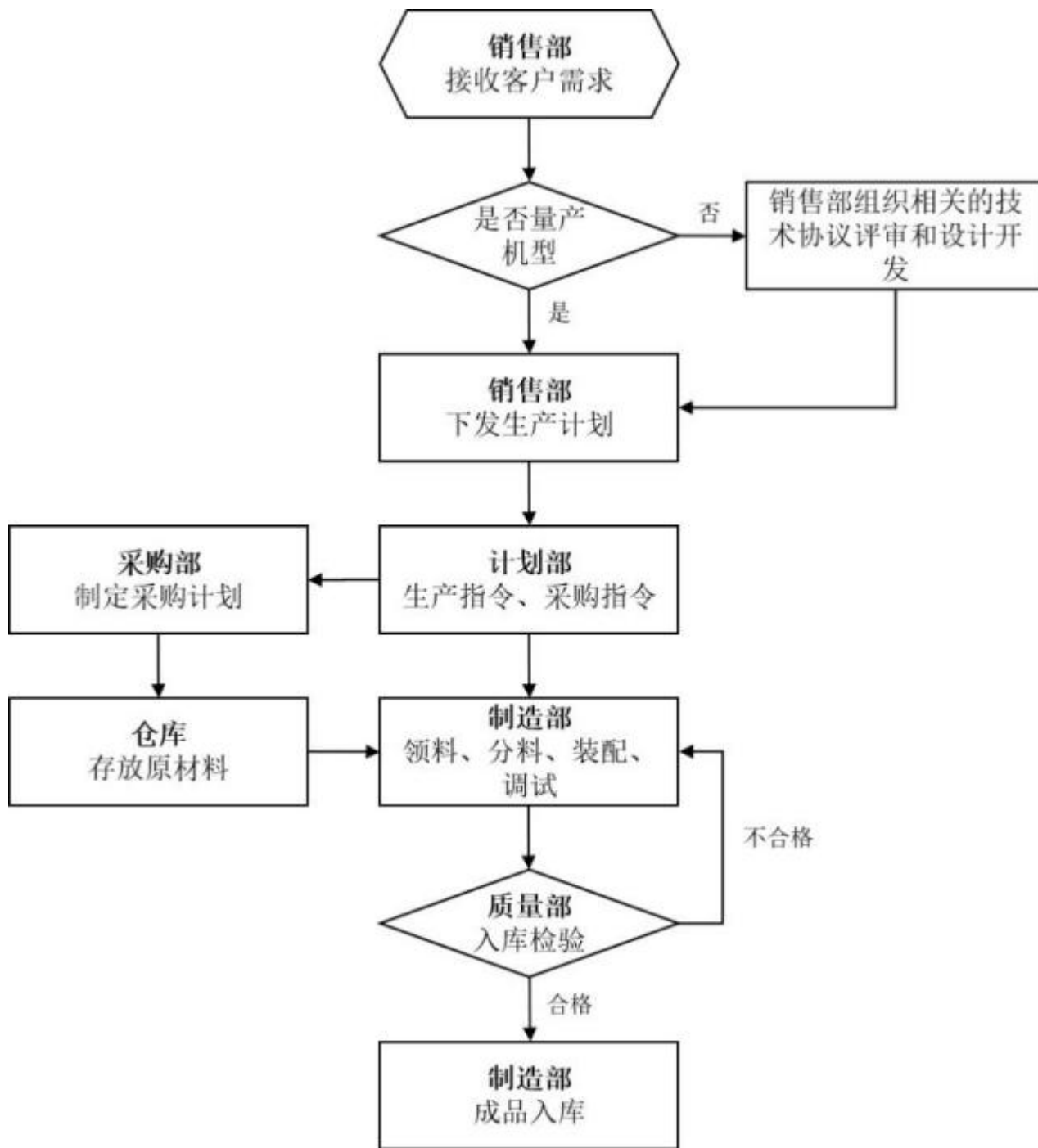
1、采购模式

为保证公司产品的质量和性能，产生新的物料需求后，公司会执行严格的供应商遴选流程。一方面，采购部会同质量部、研发部共同对供应商的经营规模、产能规模、技术水平、产品质量、产品价格、交货期、售后服务等因素进行考察，并开展样品试用或非标准部件定制加工验证；另一方面，财务部、法务部对供应商的财务报表、账期、法律风险、营业资质、合同条款进行分析与核查，最终确定合格供应商名录，并持续更新。目前，公司已与多家供应商建立了长期、稳定的合作关系。

公司采购的原材料主要包括集成电路、机械零件、视觉系统、温控器、继电器、连接器、传感器、PCB板、电源、导轨、计算机等。对于主要原材料，公司采取与供应商签订框架协议，按照年度、季度和月度向供应商传递滚动的采购需求预测，实际采购时再向供应商下达采购订单的方式进行采购。计划部根据销售计划和现有库存情况向采购部下达采购需求指令，明确物料需求数量和到货时间。采购部根据采购需求指令、供应商产能及交货周期制定采购订单计划和物料到货计划。原材料到货后，收发室根据物料到货计划及供应商提供的采购清单进行采购物资清点，开具送检单并将原材料转移给质量部检验，检验合格的原材料入库，不合格的原材在开具不良品处理单后退回供应商。

2、生产模式

公司在以销定产的基础上，实行订单式生产和库存式生产相结合的方式。订单式生产指根据已有的客户订单进行的生产，库存式生产指根据年度销售计划在计划部组织协调下进行的预生产。公司生产组织方式如下：



公司销售部负责接收客户需求，若客户需求产品为公司现有的量产机型，销售部将向计划部下发生产计划，计划部负责组织生产活动；若客户需求产品为全新机型，则由销售部组织相关的技术协议评审和设计开发，经技术评审和设计开发后销售部向计划部下发生产计划。计划部收到生产计划后向制造部下达生产指令，并向采购部下达采购指令。制造部根据生产指令从仓库进行领料、分料并进行模块组装、整机装配和调试工作，调试完成后交由质量部检验，合格后由制造部进行成品入库。

此外，公司还存在部分外协加工，主要包括 PCB 板焊接和线缆焊接，公司向外协厂商提供 PCB 板、电子元器件、线缆等，由外协厂商按照公司要求完成 PCB 板焊接和线缆焊接工序。

3、销售模式

公司采取直销的销售模式。

公司主要通过商业谈判和招投标方式获取订单。针对境内销售业务，销售中心按照华东、华南、西南、华北等地区进行区域化营销管理，并在各区域设置营销点，负责该区域的营销工作；为保证服务质量，客户服务中心在上海、合肥、天水等三十余座客户较为集中的城市设置了服务点，开展售后服务工作。针对境外销售业务，公司已在韩国、马来西亚、菲律宾等地配备营销及客服团队，并在马来西亚设置境外销售和客户服务中心总部进行统筹管理，提升客户服务的效率和质量。公司营销秉承“以客户为中心”的核心价值观和主动服务、定期回访的理念，销售中心负责营销、市场推广、订单跟踪、客户回访、货款回收等销售管理工作，客户服务中心负责产品的安装、调试和技术支持等工作。

4、研发模式

公司研发部门负责产品的研发和技术创新，公司总部建立了以分选系统研发中心、测试系统研发中心为核心，PMO、销售部、质量部等多个部门紧密合作的研发体系，公司采取以自主研发为主、产学研为辅的组织形式。

公司下属子公司 STI 的新产品研发工作主要由产品部及视觉软件部共同完成，其中产品部门主要负责与客户进行技术交流及硬件部分的研发并生成图纸，视觉软件部主要负责软件的编程以及算法的设计以在图纸的基础上加载功能项目，最终运营部门根据图纸进行原材料的采购及组装制作。各部门及 STI 主要管理人员会参与整个的研发过程直到新产品可以进行量产。

公司下属子公司长川日本株式会社公司在日本设立的以研发为主要目的的子公司，主要从事模块级核心技术的开发、升级，以及提出全新设计概念及方案、可行性论证并协同总部研发部门进行合作开发。

公司的研发流程包括了设计输入、技术方案评估、项目立项、方案制定、评审和开发、测试验证和定型等阶段，根据来源和目的分为新产品研发、技术改进和技术预研三大类。

（四）公司所处行业竞争情况

1、行业竞争概况

目前，我国集成电路专用设备行业市场份额仍主要由国外知名企业所占据，该企业凭借较强的技术、品牌优势，在高端市场占据领先地位，面对我国巨大的市场需求和相对较低的生产成本，纷纷通过在在我国建立独资企业、合资建厂的方式占领大部分国内市场，其中在测试设备行业，日本爱德万（Advantest）、美国泰瑞达（Teradyne）、美国科休（Cohu）等企业占据了主要市场份额。本土企业中，包括公司在内的行业内少数专用设备制造商通过多年的研发和积累，已掌握了相关核心技术，拥有自主知识产权，具备较大规模和一定品牌知名度，占据了一定市场份额，其中以公司为代表的测试设备优势企业产品已成功进入国内封测龙头企业供应链体系，奠定了一定的市场地位。与国外知名企业相比，国内优势企业的服务方式更为灵活，产品性价比更高，具有一定的本土优势。

2、行业进入壁垒

（1）技术壁垒

集成电路测试设备涵盖机械、自动化、电子信息工程、软件工程、材料科学等多学科技术，为典型的技术密集、知识密集型高科技行业，集成电路测试设备的技术壁垒较高。集成电路测试设备企业需要经过多年的技术和市场的经验积累储备大量的修正数据，以确保性能指标达标与持续优化，并确保测试设备长期稳定运行。技术积累与改进周期漫长导致行业新进入者需通过长期研发与现场验证，才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡，因此行业具有较高的技术壁垒。

（2）人才壁垒

集成电路测试设备行业是典型的人才密集型行业。目前，国内集成电路测试设备行业中具有完备知识储备、具备丰富技术和市场经验、能胜任相应工作岗位的技术人才、管理人才、销售人才均相对稀缺，企业之间的人才争夺激烈。当前行业领先企业通过多年积累，已经形成稳定的人才储备并具备较强的品牌吸引力，而新进入者在人才招聘与培养方面存在一定难度，随着集成电路测试设备行业的发展，有技术和经验的高端人才的需求缺口日益扩大，人才的聚集和储备成为市场新进入企业的重要壁垒。

(3) 客户资源壁垒

由于下游客户特别是国际知名企业具有严格的设备准入制度，其供应商认证周期较长、设备替换意愿低，集成电路测试设备行业头部企业拥有显著的客户资源壁垒。集成电路测试设备下游客户对于设备的稳定性、精密性、可靠性与一致性等特性要求较高，测试设备企业在与下游客户建立合作关系前，需要接受客户的严格考核认证，该等认证通常包括企业成立时间、发展历史、测试设备质量、生产管理流程、供应链管理等方面。该等认证的审核周期一般都在半年以上，部分国际大型客户的认证审核周期可能长达 2-3 年。客户严格的认证制度增加了新进入的企业获得订单的难度，同时因引入测试设备周期较长，下游客户一旦选定不会轻易进行更换，新进入者很难快速打破客户既有信用和渠道网络。

(4) 资金壁垒

集成电路测试设备的研发与制造涵盖硬件工装、软件开发、可靠性测试、现场支持等多个方面，投入金额较大、回报周期较长，同时为保持技术的先进性和产品的市场竞争力，行业内企业需进行持续的研发投入，资金需求量较大。从确定研究方向、正式研发、试产到市场推广和销售的各阶段，需要投入较大的人力物力。特别是集成电路产品类别众多，性能参数不尽相同，下游客户对配套专用设备的技术和性能要求也有所不同，若无稳健资金支持，则难以承担技术开发与市场推广的双重压力，无法和市场优势企业进行有力的竞争。

(5) 产业协同壁垒

随着集成电路产业进一步精细化分工，在 Fabless 模式下，集成电路测试设备企业需要与集成电路设计企业、晶圆制造企业、封装测试企业等建立稳定紧密的合作关系才能提供高效、稳定、兼容的系统解决方案，头部企业通过整合集成电路产业链的协同效应构筑行业壁垒。为确保检验质量、效率和稳定性，集成电路测试设备企业需要与集成电路设计企业、晶圆制造企业、封装测试企业经过长时间的协作、磨合，提供符合客户使用习惯和生产标准的测试设备及配套软硬件。集成电路测试设备企业在整个产业上的协同能力需要一个持续积累的过程，对于新进入者而言，市场先入者已建立并稳定运营的产业生态链将构成其进入集成电路专用设备制造业的一大壁垒。

(五) 现有业务发展安排及未来发展战略

1. 现有业务发展安排

公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，是一家致力于提升我国集成电路专用测试技术水平、积极推动集成电路装备业升级的国家高新技术企业。公司自成立以来，主营业务未发生变化。公司秉承“诚信、务实、创新、高效”的企业文化精神，在将现有产品领域做专、做强，保持产品市场领先地位的基础上，重点开拓了探针台、数字测试机产品、三温分选机、AOI 光学检测设备等相关封测设备，不断拓宽产品线，并积极开拓中高端市场。在成功研制高端新品后，公司产品覆盖测试机、探针台和分选机三大块主要测试设备，力争成为国际领先的集成电路测试设备企业。

2. 未来发展战略

公司在深入研究集成电路专用设备行业发展规律、行业现状、市场需求和技术趋势的基础上，制定了“市场指导研发、研发提升产品、产品促进销售”的三维式立体发展模式：产品深度方向。发挥现有核心技

术优势，不断探索产品技术深度，力求将产品做精、做专，不断提高产品的市场竞争力；产品线宽度方向。通过市场调研、产品规划、现有技术延展、新技术的研究，不断开发新的产品线，为公司的发展开拓新的增长点；市场开拓方向。不断提升公司研发水平、产品品质，加强公司品牌建设，从中低端市场向中高端市场、从国内市场向国外市场开拓，将公司打造成为国际集成电路装备业的知名品牌。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	10,916,593,691.90	7,257,174,293.72	50.42%	5,901,584,373.42
归属于上市公司股东的净资产	4,734,105,145.81	3,293,568,016.37	43.74%	2,878,612,814.00
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	5,291,542,093.17	3,641,525,979.77	45.31%	1,775,054,859.92
归属于上市公司股东的净利润	1,331,383,095.29	458,433,340.48	190.42%	45,159,576.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,250,159,052.91	414,146,340.30	201.86%	-76,557,144.21
经营活动产生的现金流量净额	562,370,204.67	625,571,646.96	-10.10%	-744,096,619.38
基本每股收益（元/股）	2.12	0.73	190.41%	0.07
稀释每股收益（元/股）	2.09	0.72	190.28%	0.07
加权平均净资产收益率	33.05%	14.65%	18.40%	1.79%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	815,250,934.46	1,351,597,250.03	1,612,039,477.03	1,512,654,431.65
归属于上市公司股东的净利润	111,000,644.56	316,021,153.20	438,379,734.58	465,981,562.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,675,804.68	311,496,806.53	431,405,821.95	461,580,619.75
经营活动产生的现金流量净额	121,041,749.81	-201,471,064.40	165,938,505.25	476,861,014.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,005	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,737	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		数量		
					股份状态	数量			
赵轶	境内自然人	22.31%	141,562,196.00	106,171,647.00	不适用		0.00		
钟锋浩	境内自然人	5.15%	32,691,608.00	24,518,706.00	不适用		0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.45%	21,868,362.00	0.00	不适用		0.00		
杭州长川投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.98%	18,897,588.00	0.00	不适用		0.00		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.86%	18,168,254.00	0.00	不适用		0.00		
孙峰	境内自然人	2.65%	16,808,194.00	12,606,145.00	不适用		0.00		
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.31%	8,292,222.00	0.00	不适用		0.00		
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开	其他	1.05%	6,673,169.00	0.00	不适用		0.00		

放式指数证券投资基金						
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险—平安—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	其他	0.81%	5,168,992.00	0.00	不适用	0.00
广发证券股份有限公司—国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	5,138,053.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州长川投资管理合伙企业（有限合伙）为实控人赵轶之一致行动人徐昕所控制的企业。长川投资拟以协议转让的方式向杭州重湖私募基金管理有限公司（代表其所管理的“重湖-高牙 2 号私募证券投资基金”）转让公司股份 31,161,565 股（占公司当时总股本的 5.00%）。2025 年 8 月 27 日，公司收到长川投资及杭州重湖私募基金管理有限公司出具的《关于终止协议转让有关事项的函》，双方一致决定终止本次协议转让部分公司股份暨终止权益变动事项。本次协议转让终止不会导致公司控制权情况发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

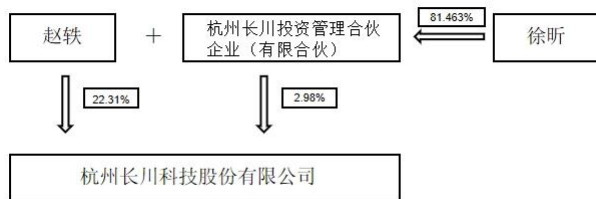
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

无